

TO-263/TO-252-SIP3

轉 SIP3 轉接板

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)

產品說明

板層：2層板（又稱雙面板或雙層板）正面：TO-263（TO263）轉 SIP Pitch：2.54mm，背面：TO-252（TO252） DPAK 轉 SIP Pitch：2.3mm

板材：FR4 板材（採用 KB 公司軍工級 A 級環保板材，軍工品質）該板材的絕緣性，板材的均勻性，銅皮跟板材基材的可靠性並且銅皮不易縮水，板材的阻抗穩定性

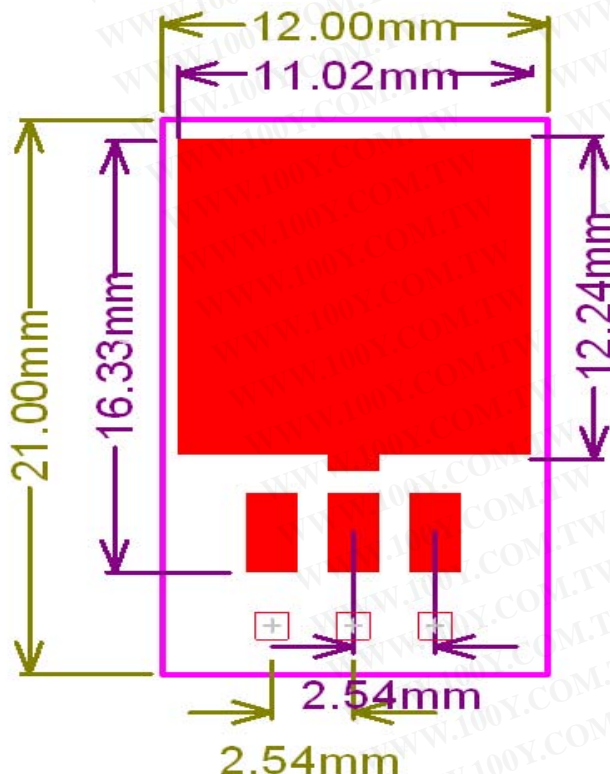
板厚：1.6mm 超厚不易變形

板色：黑油阻焊層與晶片（IC）封裝同顏色更接近晶片封裝

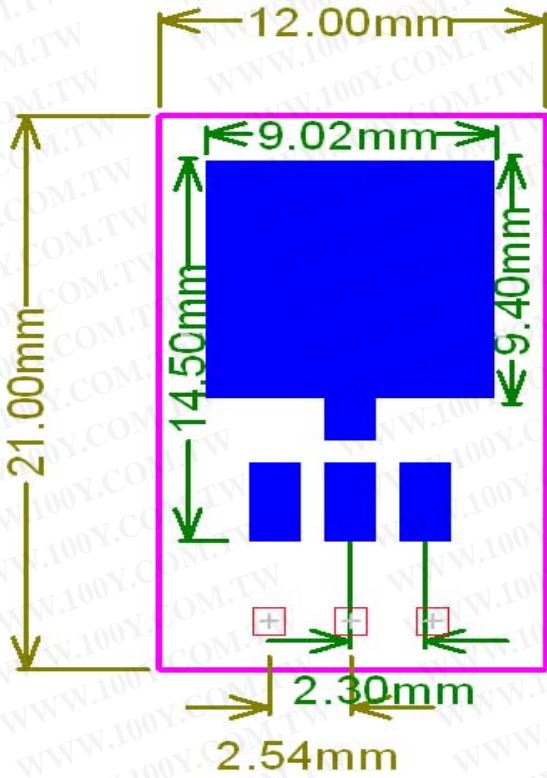
焊盤：採用化學沉金工藝（即焊盤表面鍍金）焊盤與 IC 引腳接觸電阻更小、焊點更牢靠、美觀、防腐蝕、抗氧化、無鉛更環保

轉接板正背面尺寸（如下圖）

<正面>：TO-263（TO263）焊盤間距 Pitch：2.54mm & 1.9mm SIP：2.54mm



<背面> : TO-252 (TO252) D-PAK 焊盤間距 Pitch : 2.3mm SIP : 2.54mm



【用途】：本轉接板適用於以下“貼片晶片封裝”轉成插件，購買時務必請仔細核對

TO263 (TO-263) 轉 SIP3 Pitch : 2.54mm 即：焊盤間距離（引腳間距）<焊接位置：轉接板正面>

TO252 (TO-252) DPAK 轉 SIP3 Pitch : 2.3mm 即：焊盤間距離（引腳間距）<焊接位置：轉接板反面>

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)